

## Verbindungstechnik Tag Donnerstag, 12. März 2026

In der Umweltarena Spreitenbach



Alle Infos finden Sie  
auch Online



**Themen: Bonden, Mikroschweissen, Löten, Kleben und Inspizieren**

- |   |              |   |
|---|--------------|---|
| ○ | <b>08:45</b> | <b>Begrüssung</b><br>Raphael Burkart, Hilpert electronics AG  |
|   | <b>09:00</b> | <b>Material, Bondverfahren, Prüfmittel, hohe Drahtbondqualität ist planbar!</b><br>Stefan Schmitz, Bond IQ  |
|   | <b>10:00</b> | <b>GHz Plasma Technologies – Back End Applications</b><br>Jochen Reeh, PVA Metrology & Plasma Solutions GmbH  |
|   | <b>10:20</b> | <b>Laser- und Drahtbonden Verbindungstechniken für Hochstromanwendungen!</b><br>Dr. Hans-Georg von Ribbeck, Delvotec  |
|   | <b>10:40</b> | <b>Kaffeepause</b>  |
|   | <b>11:00</b> | <b>Dampfphase – Perfekt gelötete Verbindungen durch den richtigen Prozess</b><br>Michael Hanke, Rehm Thermal Systems  |
|   | <b>11:30</b> | <b>How to – Die richtigen Materialien für optimale Verlässlichkeit Ihrer Baugruppen</b><br>Michelle Clement, NAMICS Europe GmbH                                 |
|   | <b>12:00</b> | <b>Mittagessen im Restaurant «KLIMA» mit dem Motto: «Nachhaltig isst modern»</b>  |
|   | <b>13:00</b> | <b>Sauberkeit, Schichthaftung, Parameteroptimierung: Die Grundpfeiler zuverlässiger Drahtverbindungen</b><br>Stefan Schmitz, Bond IQ                            |
|   | <b>14:00</b> | <b>Sichere Verbindungen durch Argon beim Punktschweissen</b><br>Maximilian Neuner, Fraunhofer-Institut für Giesserei-, Composite- und Verarbeitungstechnik IGCV |
|   | <b>14:20</b> | <b>Oberflächenreinheit als Voraussetzung prozesssicherer Verbindungen</b><br>Stephan Whyrich, SYSTRONIC Produktionstechnologie GmbH & Co. KG                    |
|   | <b>14:35</b> | <b>Kaffeepause</b>  |
|   | <b>15:00</b> | <b>Wie vermeidet man Verbindungen die man nicht will?</b><br>Gianfranco Sinistra, REHM Thermal Systems  |
|   | <b>15:20</b> | <b>Die einzige Lötpaste? Eigenschaften, auf die Sie bei der Auswahl Ihrer Lötpaste achten sollten!</b><br>Markus Schmidt, MacDermid Alpha                       |
|   | <b>15:40</b> | <b>Trends in Robotic Soldering</b><br>Raphael Luchs, ELMOTEC AG   |
|   | <b>16:00</b> | <b>Neueste Entwicklungen im Bereich Drahtbonden und Testen</b><br>Bernhard Rebhan, Bondtec  |
|   | <b>16:20</b> | <b>Diskussionsrunde und Zusammenfassung – Hinweis zum Best-practice Drahtbond Workshop</b><br>Raphael Burkart, Hilpert electronics AG                           |



### ANFAHRT UND KONTAKT

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich ausführlich zu informieren und stellen Sie unseren Experten alle Fragen, die für Sie von Belang sind.  
Die Veranstaltung findet in der **Umweltarena Spreitenbach** statt. Die Adresse lautet:  
**Türliackerstrasse 4, 8957 Spreitenbach.**  
Parkplätze stehen zur Verfügung (Parkhaus).  
Die Umweltarena ist gut mit den ÖV's erreichbar.

Melden Sie sich heute noch an: [office@hilpert.ch](mailto:office@hilpert.ch)  
Telefon: +41 56 483 25 25

### UNSERE REFERENTEN UND PARTNER

